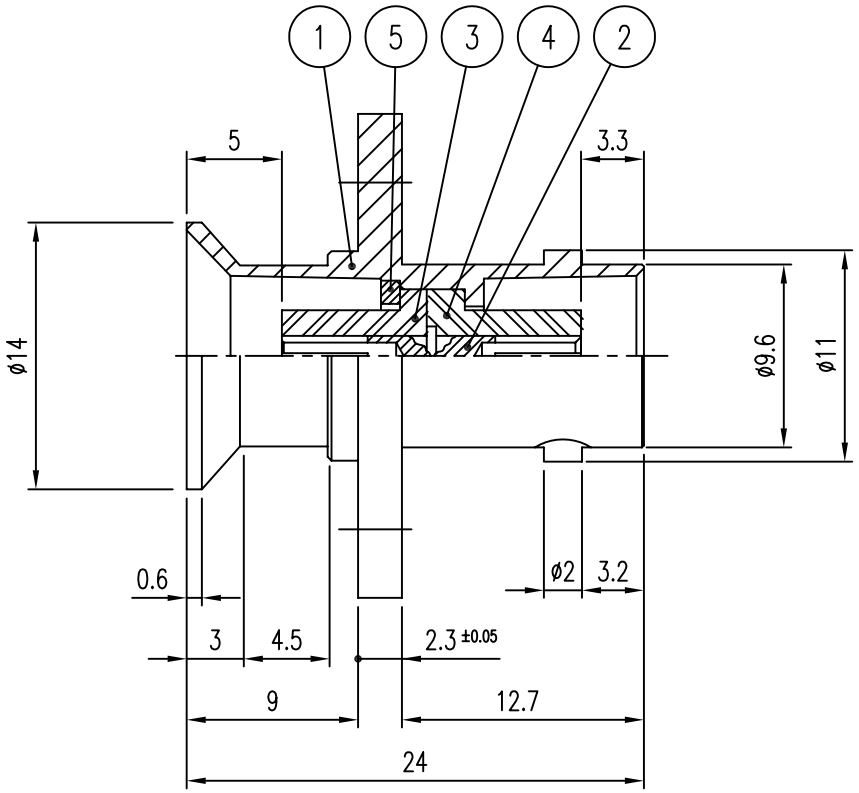
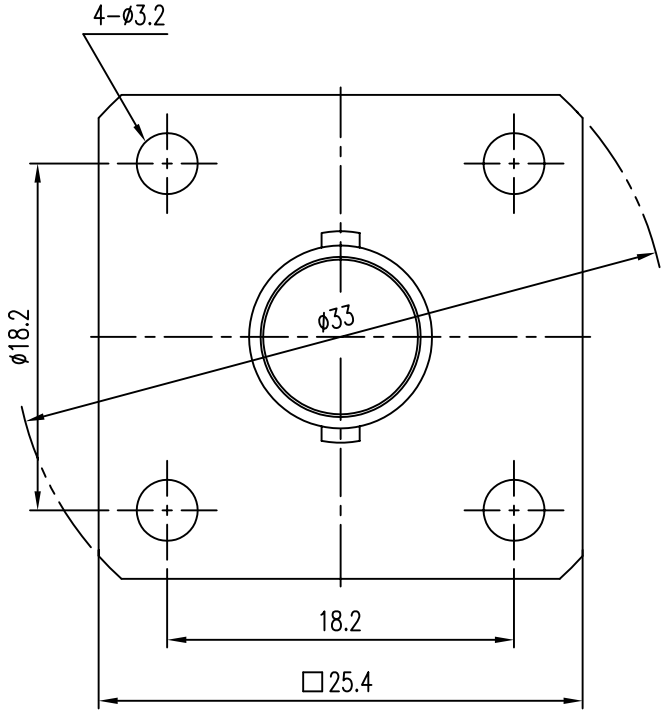
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	주기 사항 추가	김은희	안병호	2004. 6. 1.





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
5	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00051-5/1 (L7009)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00524-N/1 (HA197)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00476-N/1 (HA196)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00452-5/1 (EA210)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00167-5/1 (DA228)

⚠주 기

1. 고정 Ring 억지끼움 후 반대편에 힘을 가해 빼짐여부를 확인 할 것.
2. 조립 후 Flange 면의 평탄도를 확인한다.
   (Pannel 두께가 일정한지 확인 할 것.)

대체가능재질			
공통공차	년월일	2003. 7. 29.	
소수 각도 분수	승인		
	검도		
재질	제도		
열처리	직성부서	연 구 소	
보호피막처리	척도 NS	단위 mm	중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 BNCJ-TRUJ

A4

도번 AD00321-7/1

K361-533-000